



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201876903 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 22

(21) 申请号 201020591087. 1

(22) 申请日 2010. 11. 04

(73) 专利权人 百丰电子(上海)有限公司

地址 201708 上海市青浦区华新镇嵩山村北
青公路 3689 号

(72) 发明人 游舒淳

(74) 专利代理机构 北京华扬知识产权代理事务
所(普通合伙) 11317

代理人 王晔 王兴

(51) Int. Cl.

G06K 19/07(2006. 01)

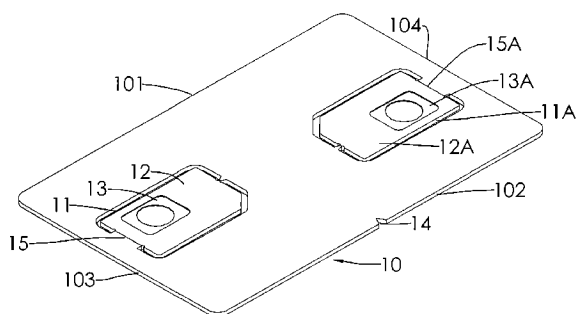
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

SIM 卡的卡基

(57) 摘要

本实用新型关于一种 SIM 卡的卡基,主要是在一矩形的片状卡基本体靠近两个相对短边处分别形成一个基板,各基板周围分别形成一个以上的沟槽,且在各基板上形成有一芯片槽,且以所述卡基本体的中心点为中心时,两基板的位置呈点对称;在各基板上的芯片槽内嵌入一芯片后即可在一卡基本体上构成两个 SIM 卡,相比于现有卡基本体,相同尺寸的卡基本体即可制造出更多的 SIM 卡,所以可减少卡基本体的使用数量,也可减少被丢弃的卡基本体废料,不仅环保还可进一步降低制造成本。



1. 一种 SIM 卡的卡基,包括有一片状卡基本体,所述卡基本体为一矩形,其具有相对的一第一长边及一第二长边,也具有相对的一第一短边及一第二短边,所述卡基本体表面靠近第一短边与第二短边处分别形成一个以上的沟槽,在所述沟槽内分别构成一第一基板及一第二基板,且在各卡基上形成一芯片槽;其特征在于:

所述第一基板邻近第一长边,所述第二基板邻近第二长边,以所述卡基本体的中心点为中心时,所述第一、第二基板的位置呈点对称。

2. 如权利要求 1 所述的 SIM 卡的卡基,其特征在于:所述卡基本体上的各沟槽为不连续的,且在卡基本体和第一、第二基板间形成易折断的衔接部。

3. 如权利要求 2 所述的 SIM 卡的卡基,其特征在于:所述卡基本体在第二长边的中央形成一分离切口。

4. 如权利要求 3 所述的 SIM 卡的卡基,其特征在于:所述卡基本体上第一、第二基板周围形成的沟槽数量为两个。

5. 如权利要求 4 所述的 SIM 卡的卡基,其特征在于:所述第一、第二基板的尺寸与迷你用户身份识别模块卡的协议规格相同,其呈矩形,其长为 25 毫米,宽为 15 毫米,且第一、第二基板远离卡基本体第一、第二短边的其中一角形成有一倒角。

SIM 卡的卡基

技术领域

[0001] 本实用新型关于一种 SIM 卡的卡基,特别关于一种可减少被丢弃的卡基废料,并可用相同数量的卡基本体制造比现有技术更多 SIM 卡的 SIM 卡卡基。

背景技术

[0002] 在现代社会中,手机是一种广泛使用的通讯工具,且在每个手机内会设有一 SIM(Subscriber Identity Module,用户身份识别模块)卡,该 SIM 卡可储存手机使用者的账户数据、短消息及号码簿;SIM 卡大多数为国际标准 ISO07818 的协议规格,其大致呈矩形,其长为 25 毫米,宽为 15 毫米,且在矩形的其中一角设有一倒角,该尺寸的 SIM 卡又称为迷你用户身份识别模块(Mini SIM);请参阅图 5 所示,现有 SIM 卡主要由一卡基本体 90 与一芯片(图中未示)所构成,卡基本体 90 为一矩形片状体,其具有相对的两个长边与相对的两个短边,卡基本体 90 表面靠近其中一短边处形成有数个沟槽 92,由沟槽 92 围成的空间即构成一基板 91,基板 91 上形成一芯片槽 93,供植设芯片用,因而在基板 91 上的芯片槽 93 内嵌入一芯片后即完成了一现有 SIM 卡,当使用者要使用该 SIM 卡时,便沿着三个沟槽 93 将嵌有芯片的基板 91 从卡基本体 90 上取下。

[0003] 但是,为了配合芯片植入机嵌入芯片的位置,只能在一卡基本体 90 的特定位置形成一基板 91,但使用者使用的只有嵌有芯片的基板 91,且基板 91 的面积只占卡基本体 90 的一小部分,当嵌有芯片的基板 91 从卡基本体 90 上拆下后,卡基本体 90 即变成废料而会被丢弃,造成资源的浪费。以上所述皆为现有技术的不理想之处,由此可见,现有技术有待进一步改进,谋求可行的解决方案。

实用新型内容

[0004] 有鉴于前述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种 SIM 卡的卡基,其可使用相同数量的卡基本体制造比现有技术更多的 SIM 卡,进而降低制造成本。

[0005] 为达成前述目的所采取的主要技术手段是使所述 SIM 卡的卡基包括一片状卡基本体,所述卡基本体为一矩形,其具有相对的第一长边及一第二长边与相对的第一短边及一第二短边,所述卡基本体表面在靠近第一短边及一第二短边处分别形成有一个以上的沟槽,在所述沟槽内分别构成一第一基板及一第二基板,且在第一、第二基板上形成一芯片槽;其中:

[0006] 所述第一基板邻近第一长边,所述第二基板邻近第二长边,且所述卡基本体以其中心点为中心旋转 180 度时,所述卡基本体上的第二基板与第一基板旋转前的位置重合,即为所述卡基本体的中心点为中心时,第一、第二基板的位置是呈点对称。

[0007] 因为本实用新型相比于现有卡基本体,相同尺寸的卡基本体可制造出更多的基板,可减少卡基本体的使用数量,可减少仓储空间,也可减少被丢弃的卡基废料,不仅环保还可进一步降低制造成本。

附图说明

- [0008] 图 1 为本实用新型一优选实施例的立体图。
[0009] 图 2 为本实用新型一优选实施例的俯视图。
[0010] 图 3 为本实用新型一优选实施例旋转 180 度后的俯视图。
[0011] 图 4 为本实用新型一优选实施例的分割图。
[0012] 图 5 为现有 SIM 卡的卡基附视图。

具体实施方式

[0013] 以下配合附图及本实用新型的优选实施例,进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段。

[0014] 请参阅图 1 与图 2 所示,本实用新型的一种 SIM 卡的卡基,其包括一片状卡基本体 10,卡基本体 10 为一矩形,且卡基本体 10 的尺寸可与传统的信用卡协议尺寸相同,其具有相对的第一长边 101 及一第二长边 102,也具有相对的第一短边 103 及一第二短边 104,卡基本体 10 的表面靠近第一短边 103 与一第二短边 104 处分别形成一个以上的沟槽 11、11A,由沟槽 11、11A 围成的空间即分别构成一第一基板 12 及一第二基板 12A,且在各基板 12、12A 上形成一芯片槽 13、13A;第一基板 12 邻近第一长边 101,第二基板 12A 邻近第二长边 102,卡基本体 10 以其中心点为中心旋转 180 度时,卡基本体 10 上的第二基板 12A 的位置会与第一基板 12 旋转前的位置重合,也就是以卡基本体 10 的中心点为中心时,第一、第二基板 12、12A 是呈点对称的。在基板 12、12A 上的芯片槽 13、13A 内各别嵌入一芯片(图中未示)后即在一卡基本体 10 上制作完成两片 SIM 卡;在此优选实施例中,各沟槽 11、11A 的数量可分别为两个,且各沟槽 11、11A 为不连续的,且在卡基本体 10 与第一、第二基板 12、12A 间分别形成易折断的衔接部 15、15A,当使用者要使用 SIM 卡时,便可沿着衔接部 15、15A 将第一基板 12 与第二基板 12A 与从卡基本体 10 上取下;第一、第二基板 12、12A 的尺寸可与迷你用户身份识别模块(Mini SIM)卡的协议规格相同,其大致呈矩形,其长为 25 毫米,宽为 15 毫米,且在第一、第二基板 12、12A 远离卡基本体 10 的第一、第二短边 103、104 的两个角中的其中一角形成有一倒角;在其它实施例中,第一、第二基板 12、12A 的尺寸符合协议规格为长为 15 毫米,宽为 12 毫米的微型用户身份识别模块(Micro SIM)卡。

[0015] 请参阅图 2 与图 3 所示,卡基本体 10 上的第一、第二基板 12、12A 及其上的芯片槽 13、13A 的位置对应于协议规格的芯片植入机的植入芯片位置;当第一基板 12 与第二基板 12A 要植入芯片时,如图 2 所示,先将卡基本体 10 的第二短边 104 当作前端送入芯片植入机内,用芯片植入机将芯片(图中未示)植入靠近第二短边 104 上的第二基板 12A 的芯片槽 13A 内,再如图 3 所示将卡基本体 10 旋转 180 度,将卡基本体 10 的第一短边 103 当作前端送入芯片植入机内,因为第一、第二卡基 12、12A 的位置是呈点对称,所以将卡基本体 10 旋转 180 度后的第一基板 12 的芯片槽 13 的位置仍可对应于芯片植入机植入芯片的位置,所以可将芯片植入第一基板 12 上的芯片槽 13 内,即可在一卡基本体 10 上制造两张 SIM 卡。

[0016] 在此优选实施例中,卡基本体 10 在第二长边 102 的中央形成有一分离切口 14,请参阅图 2 与图 4 所示,其方便将一卡基本体 10 裁切成两个长宽相同的卡基 16、16A,且各卡基 16、16A 上分别设有第一基板 12 与一第二基板 12A,所以一个卡基本体 10 可分开成两个可独立包装销售的 SIM 卡。

[0017] 因为本实用新型与现有卡基本体相比,相同尺寸的卡基本体 10 可制造出更多的 SIM 卡,可减少卡基本体 10 的使用数量,且可减少仓储空间,也可减少被丢弃的卡基废料,不仅环保还可进一步降低制造成本。

[0018] 以上所述仅是本实用新型的优选实施例而已,并非对本实用新型做任何形式上的限制,虽然本实用新型已以优选实施例披露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案的范围,应当可以利用上述揭示的技术内容作出些许改变或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围。

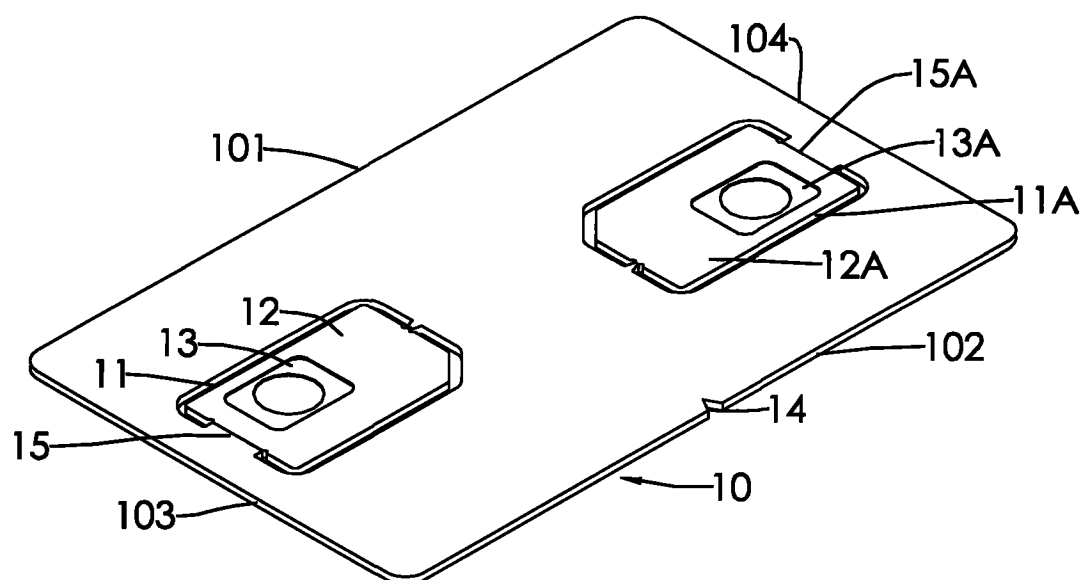


图 1

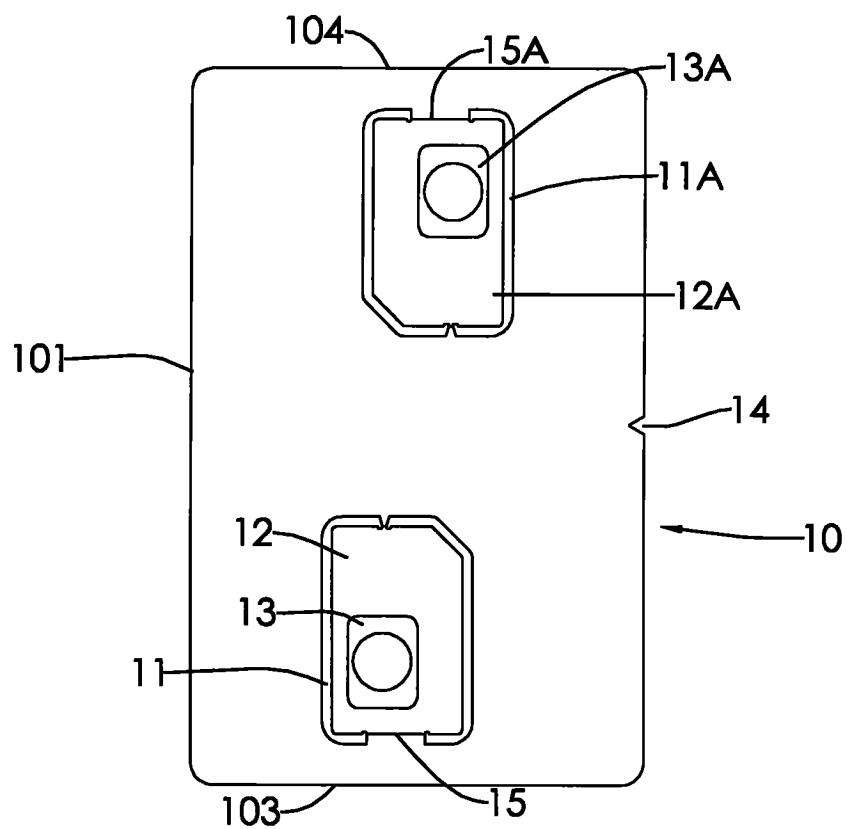


图 2

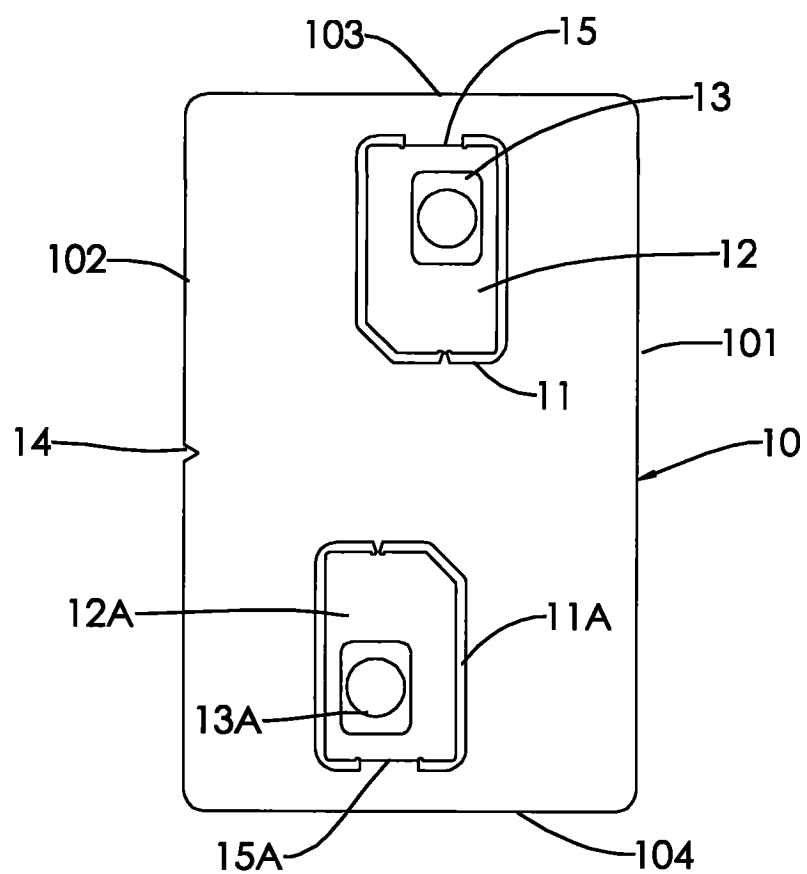


图 3

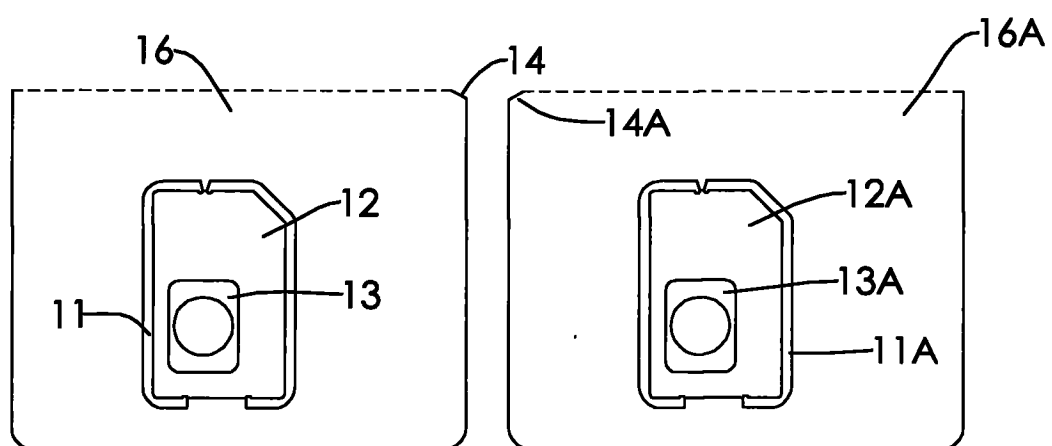


图 4

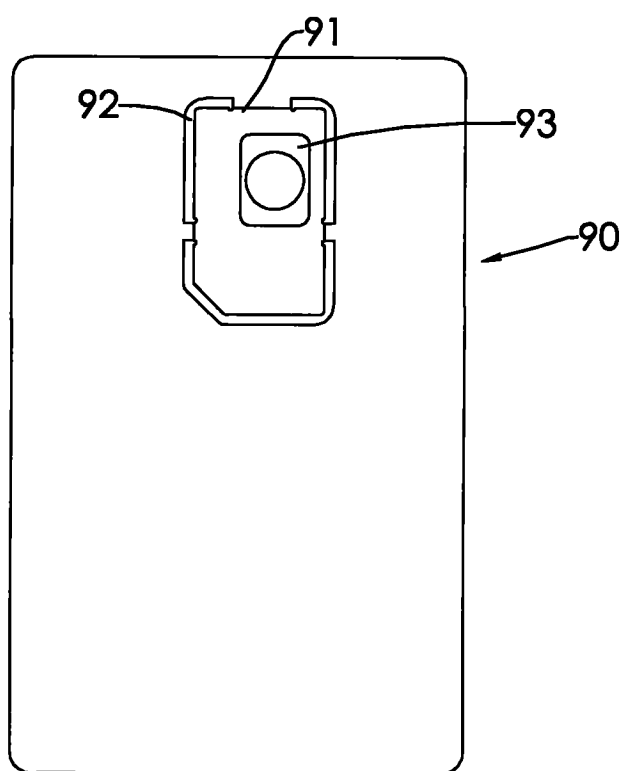


图 5